

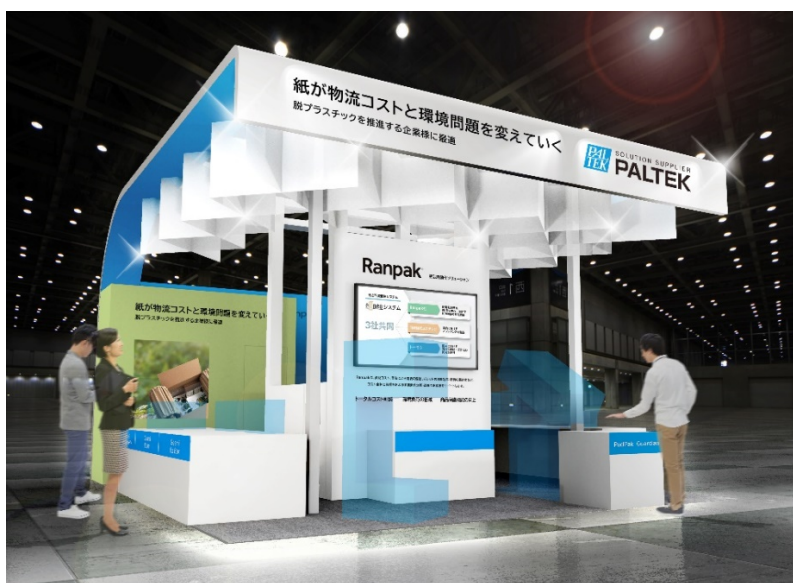
2020年10月13日

報道機関各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 P A L T E K

紙が物流コストと環境問題を変えていく！ PALTEK、「第8回 次世代 EC & 店舗 EXPO 【秋】」に出展

株式会社 P A L T E K（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：矢吹尚秀、証券コード：7587、以下 P A L T E K）は、2020年10月28日（水）～30日（金）まで、幕張メッセで開催される「第11回 JAPAN IT Week【秋】」内「第8回 次世代 EC & 店舗 EXPO 【秋】」に出展し、「紙が物流コストと環境問題を変えていく」をテーマに、Ranpak社の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進について提案します。



展示会出展イメージ

新型コロナウイルスの感染拡大に影響により、EC・物流業界は大きく様変わりしました。巣ごもり需要の増加などによりネットショッピングの利用が拡大し、物流量は大幅に増加しました。これに伴い、EC事業者や物流事業者では出荷作業のオートメーション化などの物流生産性向上が求められています。また、世界的な「脱プラスチック」の流れは加速しており、プラスチック系の梱包資材の使用を控える動きなども顕著になっています。

P A L T E Kの提供するRanpak社の紙梱包資材はプラスチック製品の梱包資材の置き換えが可能のため、食品や雑貨・日用品を扱う通信販売や実店舗での採用に加え、電子機器などの精密機器や医薬品など、さまざまな商品の緩衝材として採用が広がっています。Ranpak社の紙梱包資材は、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小、梱包作業の高速化による労働コストの削減などのトータルコストの大幅な削減が可能となります。また、FSC®認証※を受けた紙を使用しているため、環境保全に配慮されており、持続可能な社会をサポートします。

「第8回 次世代EC & 店舗 EXPO【秋】」では、2020年6月に日本国内で販売を開始した次世代緩衝材システム「PadPak®Guardian」の実演や、ラッピングシステムなどについても展示をし、Ranpak社の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進を提案します。また、新たに梱包自動化ソリューションとして、資材コスト・季節による需要の変動・パレットの積載効率・積荷の最適化など、お客様のコスト全体に影響を及ぼす要素の改善を提案します。

■ 展示会の概要

展示会名 : 第8回 次世代EC & 店舗 EXPO【秋】
開催日時 : 2020年10月28日（水）～30日（金）
 : 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
会場 : 幕張メッセ、P A L T E Kブースは、21-18
 (千葉県美浜区中瀬2-1)
主催 : リード エグジビション ジャパン株式会社
URL : <https://www.japan-it-autumn.jp/ja-jp.html>

2020 Japan IT Week 秋 幕張メッセ 内

第8回 次世代EC&店舗EXPO 秋

■ 主な出展内容

・ 次世代緩衝材システム:PadPak®Guardian

「PadPak®Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。これにより、電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。



次世代緩衝材システム
「PadPak®Guardian」

・ 高速すき間埋めシステム:FillPak®

「FillPak®」は、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。



高速すき間埋めシステム「FillPak®」

・ ラッピングシステム:Geami WrapPak®

「Geami WrapPak®」は、特許を取得したダイカット（切り込み）入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。



ラッピングシステム「Geami WrapPak®」

・ 梱包自動化ソリューション

梱包自動化ソリューションの一つである、「Pad'it!」は、梱包ラインの効率を高める、特殊な自動梱包機です。高品質な紙緩衝材を直接箱にセットすることにより、輸送中の壊れやすい製品を保護します。箱の底サイズに合わせ、1時間あたり最大900箱に紙緩衝材を作成し、製品保護を改善し自動化します。消費材、美容・ヘルスケア、事務用品、グラフィックアート、電気/電子機器、工具・機器類など幅広い業界で使用されています。



梱包自動化ソリューション

■ 専門用語説明

※ FSC® 認証 :

FSC® (Forest Stewardship Council®、森林管理協議会) は、木材を生産する世界の森林と、その森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関で、その認証は、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかなない、経済的にも継続可能な形で生産された木材に与えられます。この FSC のマークが入った製品を買うことで、消費者は世界の森林保全を間接的に応援できる仕組みです。

株式会社 P A L T E K について :

P A L T E K は、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。P A L T E K は、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

P A L T E K に関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■ この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

- ・ ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社 P A L T E K

担当者 : 広報担当 柴崎、寺田

メールアドレス : pr@paltek.co.jp

所在地 : 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話 : 045-477-2016 FAX : 045-477-2012